

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临2019-012

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于召开2018年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019年3月4日 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会主题

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年2月18日公告了《2018年度报告》（详见2019年2月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2018年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2019年3月4日 15:30-16:30

召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
(<http://roadshow.sseinfo.com>)

召开形式：网络平台在线交流

三、公司出席说明会的人员

公司董事长兼总经理王蔚先生、董事会秘书兼财务总监段佳国先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2019年3月4日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2019年3月4日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址:
<http://roadshow.sseinfo.com>, 在线进行互动交流,欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人: 胡译

联系电话: 0512-67730001

联系传真: 0512-67730808

联系邮箱: info@wlcsp.com

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日